

会社データ (平成17年9月30日現在)

商号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181(代表)
設立年月日	昭和28年3月20日
資本金	4,753,438,500円
代表者	代表取締役社長 越山 彰
従業員	374名

株主メモ (平成17年9月30日現在)

決算期	3月31日
基準日	3月31日
1単元の株式の数	100株
公告の方法	電子公告または日本経済新聞に掲載
名義書換代理人	東京都中央区日本橋茅場町1-2-4 日本証券代行株式会社 本店および各支店
同事務取扱場所	名古屋市中区栄3-3-17 名古屋証券会館5階 日本証券代行株式会社 名古屋支店
同取次所	日本証券代行株式会社 本店および各支店

株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画室企画課
TEL：052-503-8181(代表)
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>



FUJIMI TODAY Vol. 21

株式会社フジミインコーポレーテッド
株主通信 平成17年12月(第54期中間事業報告)



→P5~8 特集
—フジミから株主様へ—
皆様の声にお答えします。

FUJIMI

証券コード 5384

トップメッセージ

景況は緩やかな回復基調にあります

当社を取り巻く景況の動向は、昨年後半から今年上期にかけて続いた家電製品や携帯電話端末など電子部品関連の在庫調整局面が終息し、緩やかな回復基調をたどりました。半導体市場につきましては、米国におけるパソコン販売が好調だったことを受け、世界全体の半導体出荷額はこの年末から2006年にかけても堅調に推移するものと予想されています。また、2006年にドイツで行われるサッカーワールドカップ(W杯)に向けたデジタル家電の需要増大も半導体市場の拡大に寄与すると思われます。

一方、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)など市場の広がり期待できるものの、低価格モデルが主流となるため、金額面の伸びは期待薄との声も出ています。また世界全体では、原油高などによる原料高騰により、

収益は圧迫され、設備投資効率をより一層高めていくことが求められています。

もう一度、企業のあり方を見直します

当社は、昨年からバランス・スコアカード(BSC)の導入、運用を開始しました。ビジョンと戦略を明示し、事業ごとの切り口で戦略テーマと目標を掲げ推進するものです。また、2002年に策定した現行の「中長期経営計画」を見直し、環境分析・企業能力分析、顧客ヒアリングを実施し、BSC手法を取り込んだ「中期経営計画」を策定しています。この中期経営計画は、2010年3月期を最終年度とし、今期中の完成を目指しています。

最近では、コーポレートガバナンス(企業統治)やコンプライアンス(法令遵守)が厳しく問われるようになってきました。より機能する内部統制の仕組みづくりと、企業倫理綱領の遵守を軸に、企業の社会的責任(CSR)の観点から社内体制を見直し、株主様をはじめ当社のステークホルダーとの良好な関係構築を目指します。

当社の今期スローガンは、『実行・成長・飛躍』です。これを合言葉に、今後とも株主価値の向上に努めるとともに、グローバルに通用する企業に向けて、全社一丸となって取り組んでまいります。

皆様の一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成17年12月

代表取締役社長

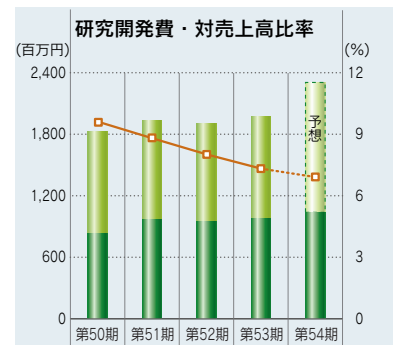
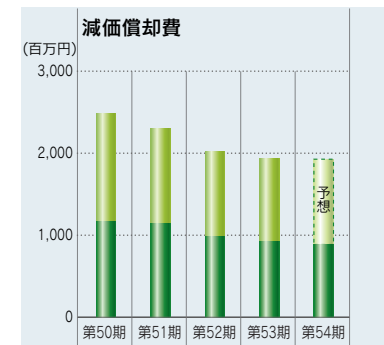
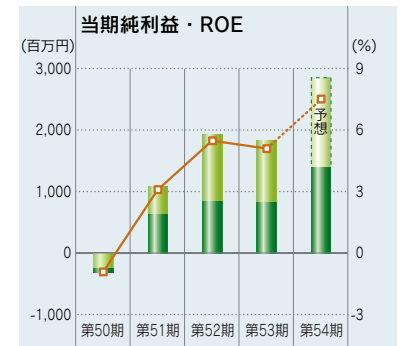
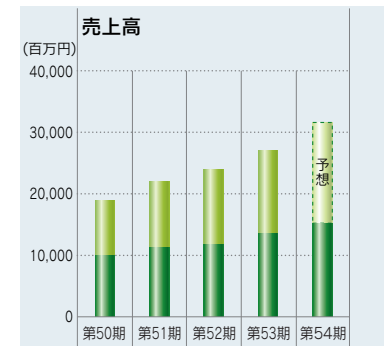
越山 彰



Akira Koshiyama

中間連結決算ハイライト

■下期 ■上期 □実績 □予想



世界的にパソコンや携帯電話の出荷が回復し、デジタル関連製品の一部に価格下落があったものの、半導体市場は総じて底堅い動きとなりました。

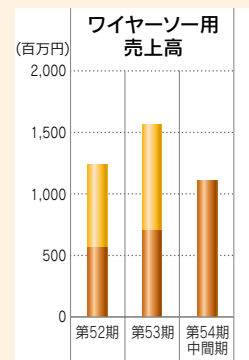
このような市場環境下、当社はグループ挙げて積極的な営業活動を展開した結果、当中間連結売上高は152.3億円となり前期比12.0%増を達成しました。一部の原材料価格急騰により売上原価率が悪化したものの、営業利益につきましては、前年同期比6.1%増の20.9億円となり、売上高営業利益率は13.8%となりました。

当中間期純利益は、前年同期比69.3%増の13.8億円となり、その結果、ROEは3.8%となりました。この大幅な増加要因は、前年に減損会計の早期適用による特別損失を4.1億円計上したことによります。

設備投資につきましては、本社、稲沢、各務原の各工場増産設備に5.2億円、研究開発センターの評価装置に3.8億円の投資を行い、設備投資総額は10.9億円となりました。

フジミの事業とセグメント情報

シリコン切断に使用されるワイヤソー用砥粒は、特に太陽電池の市場拡大を受け、全体の売上高は11.0億円(前年同期比56.3%)と好調でした。水晶デバイス用研磨材は、高性能携帯電話への買替需要や自動車の電装化の進展により市場は

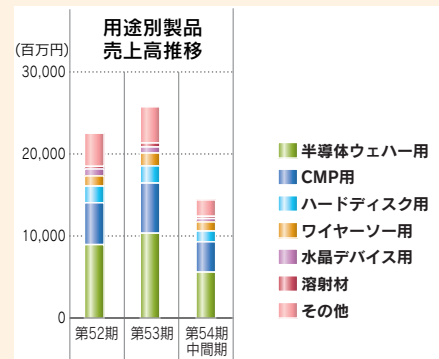


拡大したものの、水晶デバイスの小型化による消耗材の使用量減や中国製品の流入による単価下落により売上高は、4.1億円(前年同期比0.4%減)となりました。サーメット溶射材は堅調に推移し売上高は2.7億円(前年同期比29.0%増)と大幅に増加しました。

ワイヤソー用、水晶デバイス用、溶射材その他売上高の特徴



水晶デバイスは周波数制御・選択用電子部品として周波数の安定度、秩序および通信の質を守るために情報端末機器、携帯電話端末、デジタルカメラ、コードレスホンなどの、日常に密着した機器に幅広く使用されている。最近では自動車の車速感知などの制御系にも利用される。



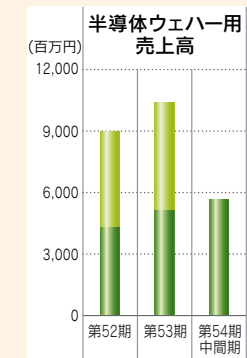
※グラフは商品を含めない自社製品みの売上高です。



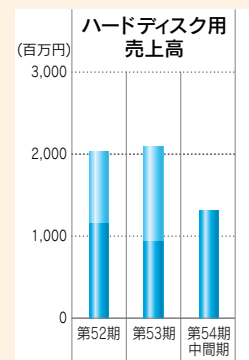
シリコンウェハーに代表される半導体基盤はそのニーズの高まりから、基盤メーカーの生産の中心が300mmウェハーへ移行が進み、それにつれて両面研磨など、より高精度な鏡面研磨が要求されてきている。

半導体ウェハー用

パソコンを中心に、OA機器やAV製品など、電子・IT関連機器類の心臓部に使用されている半導体素子。この半導体素子を製造するには、シリコンウェハーに代表される半導体基盤を高精度に鏡面研磨しなければなりません。半導体市場全体は、パソコンの需要回復、携帯電話端末の高機能化による出荷増、携帯音楽端末などの普及により底堅い展開となりました。ラッピング材「FO」は一部リサイクルや固定研削の動きから影響を受け減少したものの、ポリシング材「GLANZOX」は300mmウェハーの拡大により大幅に売上を伸ばし、半導体ウェハー向け製品全体では、売上高56.6億円(前年同期比9.8%増)となりました。



パソコンの高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量メモリーのハードディスクが注目を集めています。このような環境下、ディスクの表面研磨についても、シリコンウェハーと同等以上の研磨水準が要求されるようになりました。フジミはこの分野でも高い評価と信頼を得ています。パソコン向けのディスク市場は、インターネットのインフラが整備され高性能パソコンが低価格で市場投入されたことにより買替需要が増加しました。また、HDD搭載型DVDレコーダーや小口径HDD内蔵型携帯音楽機器等のデジタル家電の拡大によりハードディスクの需要は堅調に推移し、当社のディスク向け製品も売上高13.1億円(前年同期比39.5%増)と大幅な改善を示しました。

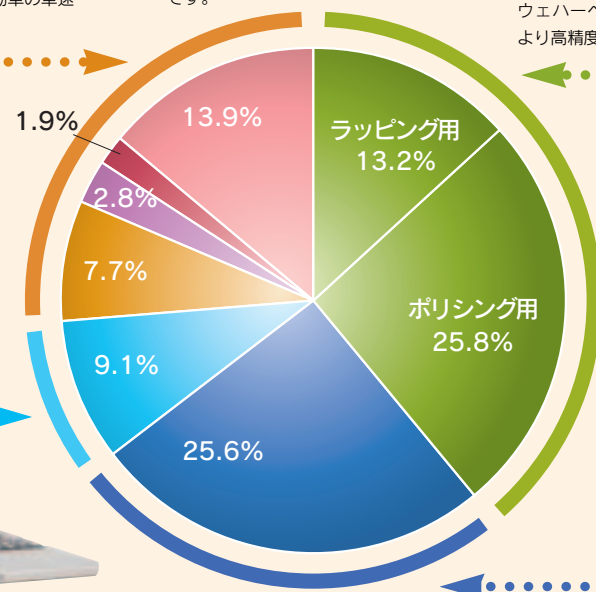


また、HDD搭載型DVDレコーダーや小口径HDD内蔵型携帯音楽機器等のデジタル家電の拡大によりハードディスクの需要は堅調に推移し、当社のディスク向け製品も売上高13.1億円(前年同期比39.5%増)と大幅な改善を示しました。

ハードディスク用



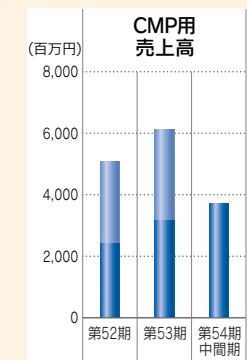
磁性体を塗布したアルミニウムやガラスのディスクを一定の間隔で何枚も重ねた構造の記憶装置で、モーターで高速に回転させ磁気ヘッドを近づけてデータを読み書きする。パソコンをはじめとするほとんどのコンピュータに搭載されており最近ではデジタル家電への搭載が進んでいる。ディスクの大きさは、ノートパソコン向けは2.5インチ、デスクトップパソコン向けは3.5インチがそれぞれ主流。



情報通信機器やエレクトロニクス製品の高集積化・小型化の進展に伴いデバイスウェハーの多層配線化への要求が高まったことから、中央集積回路やメモリなどの記憶素子を中心とした多くのデバイスにCMP(化学的機械的平坦化)プロセスが導入されている。

CMP用

IT時代の進展に伴い、半導体の集積度を上げるため半導体チップ上の多層配線の重要性が高まり、この多層化のための必須技術として実用されているのがCMP(化学的機械的平坦化)。フジミの長年にわたるシリコンウェハーのファイナルポリシング材のノウハウを応用展開し製品開発を進め、市場から高い評価を得ており、CMPは今後も高成長が期待される分野です。エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体デバイスもさらなる高集積化・多層配線化が要求されています。その優れた品質特性から「PLANERLITE」シリーズを中心にユーザーの採用が拡大し、売上高は36.9億円(前年同期比15.6%増)と順調な伸びを示しました。



特集 —フジミから株主様へ—

皆様の声にお答えします。

株主様からフジミへ。前号の株主通信にも大勢の株主様からたくさんのお声を頂戴しました。フジミは、開かれた企業であり続けるために、どんな小さな声にも誠実でありたいと考えています。今号では、最近寄せられた株主様のご質問から、特に8つをピックアップしてお答えすることにしました。

分級方法：粒の大きさをそろえる技術。水中で行う湿式分級（沈降速度の違いを利用）と空気中で行う乾式分級（落下速度の違いを利用）がある。

粒度：粒のキメの細かさのこと。

ラッピング材：工作面を極めて精密な平面に仕上げるための研磨材。

ポリシング材：加工面を精密な鏡面に仕上げるための薬品添加された研磨材。

Q1 フジミという会社名の由来は何ですか？（栃木県 44歳 女性）

フジミの名は、戦前にあった不二見焼合資会社（現 不二見セラミック株式会社）から来ています。当社の創業者である故越山照次は、第2次世界大戦のさなか、軍の要請により国産研磨材の製造を目指し、東京工業大学窯業部の鈴木教授から分級方法*と粒度*の判別方法について教えました。その後、海軍の軍需工場の指定を受けて、研磨材の生産を試みましたが、終戦と同時に中止を余儀なくされました。戦後

復興の進む中、新規事業展開の機会を伺っていたところ、昭和25年3月、東京光学機械株式会社よりレンズ研磨材の生産再開の依頼があり、長年従事していた不二見の名前を用い、同年8月、名古屋市昭和区に不二見研磨材工業所を創業、本格生産を開始いたしました。また、現在の社名であるフジミインコーポレーテッドは、1991年、当社がCI活動の一環として商号変更したものです。

Q2 各事業の業界内でのシェアが分かりましたら教えてください。（愛知県 77歳 女性）

シリコンラッピング（一次/二次研磨・平坦化）材*は世界シェアで96%、シリコンファイナルポリシング（最終工程・鏡面研磨）材*は同86%。CMP向けは、同

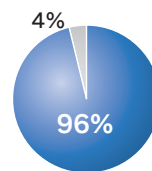
12%のシェアを占めています。ハードディスクについてはガラスディスク用ラッピング材が同84%、アルミディスク用ポリシング材が同35%となっています。いずれも

2005年3月末の実績をもとに当社内で推定したものです。フジミが“小さな世界企業”

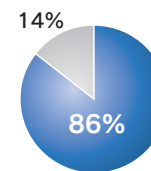
と呼ばれるのは、こうした世界市場における健闘が評価されたものかもしれません。

■ 市場占有率（2005年3月末・世界全体・自社推定） ● フジミ ● 他社

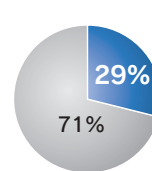
シリコンラッピング材



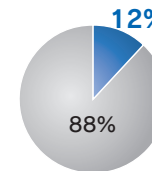
シリコンファイナルポリシング材



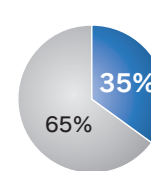
シリコン切断用研磨材



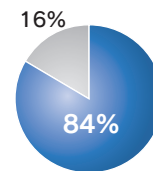
CMP用研磨材



アルミディスク用ポリシング材



ガラスディスク用ラッピング材



Q3 フジミの製品は、私たちの身近な場所でどのように用いられていますか。それが分かることもっと身近に感じられます。（神奈川県 57歳 女性）

フジミの研磨材を直接目にするのはなかなか難しいかもしれません。しかし、私たちの研磨材で磨かれた半導体基盤やハードディスクは、家庭内の電気製品やオフィスのIT関連機器の中核部品として使われ急速に普及しています。たとえば、携帯電話や時間を刻む時計の水晶振動子、職場で使っているパソコンやご家庭のハードディ

スク搭載型DVDレコーダーも当社の研磨材で磨かれたものかもしれません。また、マイカーに搭載されたカーナビ内の記憶装置、カメラやメガネなどのレンズも当社の製品でピカピカに磨かれたものかもしれません。フジミの製品は、直接目にするにはできませんが、いろいろなところで社会をしっかり支えています。

Q4 フジミに中長期経営計画がありましたら、ご紹介ください。（東京都 50歳 男性）

フジミは、2007年3月期を最終年度として「ROE10%以上」とする中長期企業ビジョンを掲げており、この数値目標に加え「真にグローバルで社員一人ひとりが誇りを

持てる企業」の構築を目指しています。今年4月からは新たなマネジメント・ツールとしてBSC手法*を導入し、事業ビジョン、戦略目標、施策の関連付けを行い、事業単位で進

BSC手法：全社ビジョンを実現するため事業ごとの切り口で戦略目標や業績評価目標を設定し、アクションプランまで展開する経営手法。

半導体製造受託会社：大手エレクトロニクスメーカーから特定用途の半導体を受託生産する半導体製造の専門メーカー。

CMP：半導体集積回路の高集積化に対応するため、回路を多層配線するために、電子回路の表面を化学的・機械的に平坦化する技術。



SiC (炭化ケイ素) 基板：現在の主要な半導体基盤はSi (シリコン) などの基板に配線を施して作られているが、SiCはSiよりも遙かに化学的に安定しており、ダイヤモンドに次ぐ硬質材料です。高温・放射線下での耐環境デバイス、あるいは高周波・パワーデバイス用半導体材料として有望な次世代基板として大いに期待されている。

抄管理の徹底を図っています。ただ、事業環境の変化が急速に進む中、当社の事業ごとのビジョンを再検討して、進むべき方向を明確化するため、2010年3月期を最終年度と

する中期経営計画を現在策定中で、来年度より実行に入る予定です。戦略目標を可視化し組織横断的に施策を実行することにより、目標の達成度を高めたいと思っています。

Q5 今後の海外展開の方向についてどのように考えているのかお教えてください。(滋賀県 40歳 男性)

半 導体産業は世界規模で拡大しており、当社も取引先の半数が世界各地にあります。現在、アメリカとマレーシアに生産・販売拠点を、イギリス、ドイツに販売拠点を置いています。成長著しい中国、台



湾には現地駐在員を置いて対応していましたが世界有数の半導体製造受託会社*のひしめく台湾に、2005年10月、新たに台湾事務所を開設しました。これにより、拡大が見込まれるCMP*分野において、グローバルなサポート体制の構築を進めユーザーニーズに迅速に 대응してまいります。

Q6 新しい技術に対応する産学連携については、どのような取り組みがされていますか？(京都府 63歳 男性)

産 学連携の一つとして、優れた電気特性をもち、次世代半導体基板として期待されているSiC (炭化ケイ素) 基板*の研究加工技術を名古屋工業大学と研究しています。この研究は2005年7月、経済産業省

の開発費補助事業にも選定されました。本研究は消費電力の低減化の確立と事業化を目指したもので、京都議定書が定める、地球温暖化防止への貢献策の一つとして大いに期待されています。

Q7 株主還元策についての方針をお聞かせください。(熊本県 44歳 男性)

当 社は株主様に対する適正な利益還元を行うことを経営の最重要課題と考えています。

還元策の一環として、平成17年3月31日現在の株主様に対して、1:2の株式分割を実施し、配当については平成17年3月期は年間36円とし、前年度の年間32円から4円増配しました。今期以降の配当については、収益拡大に連動した還元方針を一層明確化するため、連結配当性向30%以上を基準として実施していきたいと思っております。株式分割を考慮した実質的な配当金は2倍となる見込みです。内部留保については、国際的

な競争力強化のための設備投資、新製品の研究開発投資や新規事業開拓等に充当し、将来の事業展開に活用することにより、持続的な事業拡大を通して株主還元を図ってまいります。

また、一部の株主様より株主優待制度希望の声をいただいておりますが、当社の事業の性格上、自社製品に関連した優待制度は難しい面もあり、現在は実施していません。今後については、企業の収益拡大による配当還元を基本としますが、株主様の声をお聞きし、総合的な株主還元策を検討してまいります。

Q8 CMPの事業戦略についてお聞かせください。(愛媛県 55歳 男性)

I T時代の伸展で、パソコンや携帯電話をはじめとする電子機器の高性能化・小型化の流れにより、市場からはICチップのさらなる高集積化が求められています。その技術に欠かせないのがCMP (Chemical Mechanical Planarization: 化学的機械的平坦化) 技術。当社では長年にわたってシリコンウエハー向け研磨材を主力事業としてきましたが、CMP事業はそれに次ぐ主力事業の一つとして位置づけています。CMP市場規模は、2005年6億ドル、2007年7億ドル、2010年には9億ドルに迫り、高成長

が期待される市場です。当社では世界シェアを現在の12%から倍増させるべく全社を挙げて日々挑戦していますが、技術革新とともに顧客ニーズはますます多様化しています。いち早くユーザーニーズを捉え、それにお応えしていくことが当社の世界シェア拡大の鍵となるため、台湾事務所の開設は、当社のCMP戦略にとって大きな役割を果たします。それと同時に常に最新鋭の設備への投資をし、競合他社とのさらなる差別化を図ってまいります。

中間連結財務諸表

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

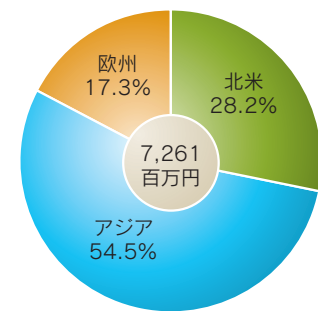
中間連結損益計算書	第53期	第53期中間期	第54期中間期
	平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	平成16年4月1日から 平成16年9月30日まで	平成17年4月1日から 平成17年9月30日まで
売上高	27,109	13,594	15,230
売上原価	18,206	9,031	10,319
販売費及び一般管理費	5,388	2,585	2,812
営業利益	3,514	1,977	2,097
営業外収益	133	80	63
受取利息/配当金	34	30	35
その他	99	49	27
営業外費用	33	12	16
支払利息	30	11	13
その他	3	0	2
経常利益	3,614	2,044	2,144
特別利益	44	39	1
特別損失	510	488	25
税金等調整前中間(当期)純利益	3,147	1,595	2,120
法人税、住民税及び事業税	1,490	905	699
法人税等調整額	△170	△130	17
少数株主利益	4	1	16
中間(当期)純利益	1,823	818	1,386

海外売上高

(単位：百万円)

	第53期中間期	第54期中間期
海外売上高 (連結売上高)	6,583 (13,594)	7,261 (15,230)
連結売上高に 占める割合	48.4%	47.7%

海外売上高構成比(第54期中間期)



* 各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。

北米: 米国、カナダ
 アジア: 台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国
 欧州: 英国、デンマーク、ドイツ

売上高

半導体ウェハー向け製品は、300ミリウェハーの世界需要拡大を背景に、ポリシング材の売上は大幅な伸びを示しましたが、ラッピング材はリサイクル使用の増加の影響を受け、減少しました。多層配線工程向けCMPスラリーは、特に米国子会社の順調な売上により増加しました。また、ハードディスク向け製品も、ノートパソコンの増加や、ハードディスクの家電品への搭載により売上は増加しました。その結果、総売上高は、前期比12.0%増となりました。

営業利益

一部の原材料の高騰により、売上原価率が1.3ポイント悪化し、販売費及び一般管理費のコスト削減にも努めましたが、営業利益は、前期比6.1%の増加にとどまりました。

中間純利益

前期に減損会計の適用により特別損失を4.1億円計上したため、当中間純利益は前期比5.6億円増の13.8億円(前期比69.3%増)となりました。

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

中間連結貸借対照表	第53期	第53期中間期	第54期中間期
	平成17年3月31日現在	平成16年9月30日現在	平成17年9月30日現在
資産の部			
流動資産	25,874	24,081	27,723
現金及び預金	12,594	10,848	12,980
受取手形及び売掛金	7,839	8,598	9,314
たな卸資産	4,262	3,508	4,326
その他	1,202	1,145	1,126
(貸倒引当金)	△25	△20	△25
固定資産	17,573	18,800	17,936
有形固定資産	14,268	15,008	14,614
建物及び構築物	6,487	6,164	6,402
機械装置及び運搬具	2,755	2,601	2,732
土地	3,528	3,540	3,546
その他	1,496	2,702	1,933
無形固定資産	366	384	303
投資その他の資産	2,939	3,406	3,018
資産合計	43,448	42,881	45,660
負債の部			
流動負債	7,051	6,950	7,857
支払手形及び買掛金	3,641	3,871	3,932
短期借入金	604	357	923
その他流動負債	2,805	2,721	3,001
固定負債	311	518	299
負債合計	7,362	7,469	8,157
少数株主持分			
少数株主持分	36	35	55
資本の部			
資本金	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	5,040	5,038	5,042
利益剰余金	28,112	27,342	29,165
その他有価証券評価差額金	93	65	148
為替換算調整勘定	△199	△44	49
自己株式	△1,751	△1,778	△1,710
資本合計	36,049	35,377	37,447
負債及び資本合計	43,448	42,881	45,660

流動資産

受取手形及び売掛金が大幅に増加し、流動資産は前期末比18.4億円増加しました。

固定資産

当中間期の設備投資は、本社工場増設及び商品開発の設備などにより10.9億円となりました。減価償却費が8.7億円となり、有形固定資産は前期末比3.4億円の増加となりました。無形固定資産は、減価償却が進み、0.6億円減少しました。投資その他の資産は、投資有価証券の時価評価替により0.7億円増加しました。

負債

流動負債は、前期末比8.0億円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加と子会社フジミコーポレーションの短期借入金の増加によるものです。固定負債は、繰延税金負債の減少により0.1億円の減少となりました。

株主資本

株主資本は、前期末比13.9億円増加しましたが、株主資本比率は、総資産の増加により1ポイント減の82.0%となりました。

中間個別決算の概要

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

中間連結キャッシュ・フロー計算書	第53期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	第53期中間期 平成16年4月1日から 平成16年9月30日まで	第54期中間期 平成17年4月1日から 平成17年9月30日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,584	1,747	776
税金等調整前中間(当期)純利益	3,147	1,595	2,120
減価償却費	1,925	921	877
土地減損損失	412	412	—
売上債権増減額	△850	△1,242	△1,408
仕入債務増減額	697	751	232
たな卸資産増減額	△1,101	△490	12
その他	△75	△100	△59
小計	4,155	1,846	1,775
利息及び配当金の受取額	34	28	35
法人税等の支払額	△607	△154	△1,021
その他	1	25	△13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,851	△1,283	△492
有価証券の売却による収入	66	66	—
投資有価証券の取得による支出	△2	△1	△1
有形固定資産取得による支出	△1,738	△1,222	△491
その他	△177	△125	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△518	△582	20
短期借入金の純増加(減少)額	172	△97	271
自己株式の取得及び売却による収支	△220	△248	42
親会社による配当金の支払額	△471	△236	△293
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20	19	93
現金及び現金同等物の増加(減少)額	1,193	△99	398
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	356	—	—
現金及び現金同等物期末残高	11,419	11,419	12,969
現金及び現金同等物期末残高	12,969	11,320	13,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、7.7億円(前年同期比55.6%減)となりました。主な要因としては、税金等調整前中間純利益21.2億円(同32.9%増)及び減価償却費8.7億円(同4.7%減)に加え、仕入債務の増加2.3億円(同69.1%増)があったものの、売上債権の増加14.0億円(同13.4%増)及び法人税の支払額が10.2億円(同563.1%増)と大幅に増加したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は4.9億円(同61.6%減)となりました。これは主に有形固定資産取得による支出4.9億円(同59.8%減)によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は0.2億円(同前年同期は5.8億円使用)となりました。これは短期借入金の増加2.7億円による収入及び自己株式の売却収入0.4億円に対し、親会社による配当金の支払額2.9億円によるものです。

現金及び現金同等物は、税金等調整前中間純利益が21.2億円(前年同期比32.9%増)となり、売上債権の増加及び法人税等の支払額の増加があったものの、前連結会計年度末に比べ3.9億円増加いたしました。この結果、資金残高は133.6億円となりました。

(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

中間損益計算書	第53期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	第53期中間期 平成16年4月1日から 平成16年9月30日まで	第54期中間期 平成17年4月1日から 平成17年9月30日まで
売上高	23,422	11,906	12,842
売上原価	15,835	7,963	8,874
販売費及び一般管理費	4,328	2,131	2,283
営業利益	3,258	1,811	1,684
営業外収益	229	129	118
営業外費用	3	1	1
経常利益	3,484	1,939	1,801
特別損益	△466	△449	△24
税引前中間(当期)純利益	3,017	1,490	1,777
法人税、住民税及び事業税	1,310	820	622
法人税等調整額	△65	△113	17
中間(当期)純利益	1,772	783	1,137
前期繰越利益	2,370	2,370	2,564
中間配当額	234	—	—
中間(当期)未処分利益金	3,908	3,153	3,702

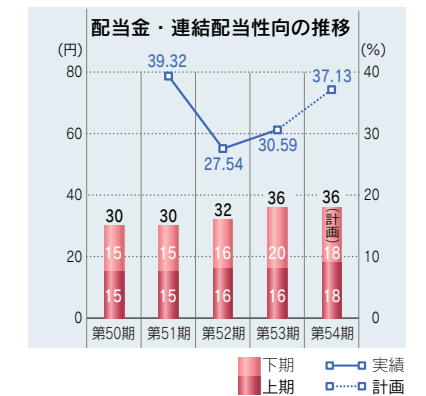
(単位：百万円、百万円未満は切り捨てています。)

中間貸借対照表	第53期 平成17年3月31日現在	第53期中間期 平成16年9月30日現在	第54期中間期 平成17年9月30日現在
資産の部			
流動資産	23,238	22,175	24,497
固定資産	18,329	19,032	18,623
資産合計	41,568	41,207	43,121
負債・資本の部			
流動負債	5,879	6,172	6,526
固定負債	292	450	296
負債合計	6,172	6,622	6,823
資本金	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	5,040	5,038	5,042
利益剰余金	27,260	26,506	28,064
その他有価証券評価差額金	93	65	148
自己株式	△1,751	△1,778	△1,710
資本合計	35,396	34,585	36,298
負債資本合計	41,568	41,207	43,121

配当金及び連結配当性向の推移

当社はこれまで安定配当を基本とする株主還元策を継続してきましたが、今後は業績に応じた積極的な株主還元を実施すべく、第54期以降につきましては連結配当性向30%以上を目標として取り組んでいきます。

第54期中間期の配当金は1株あたり18円とし、年間配当金については36円を予定しています。2005年3月末日を基準日として実施した株式分割(1:2)を考慮すると、実質配当は2倍(100%増)となります。

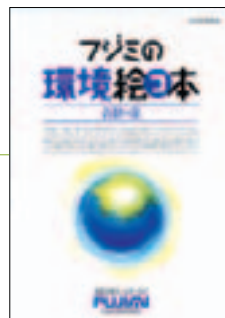


注1) 第54期の配当性向は、通期配当36円(計画)を一株あたり予想当期純利益(通期)96.96円で除して算出。

注2) 2005年3月31日付の株主に対し、5月20日に1:2の株式分割を実施。

01 環境報告書「フジミの環境絵コ本」を創刊

当社の環境への取り組みを、初めて環境報告書としてまとめました。企業活動と地球環境との関係、私たちの環境に対する考え方や活動を絵本形式にしてわかりやすく伝えています。今後も環境保全活動、安全な商品の提供、社会貢献活動に努力していきます。
(当社ホームページ <http://www.fujimiinc.co.jp> にも記載されています。ご参照ください。)



02 個人投資家向けIRフェアに参加

9月9日(金)・10日(土)の両日、名古屋国際会議場(名古屋市熱田区)において、愛・地球博パートナーシップ事業として野村證券が主催する「東海三県資産管理フェア2005」が開催され、当社も地元東海エリアの上場企業の一員として、一昨年、昨年に引き続き出展参加しました。
当社のブースには2日間で昨年を大きく上回る約1,000名の方が来場し、「製品の用途」「業績」「今後の見通し」等の説明に熱心に耳を傾けられました。個人投資家の皆様の当社に対する関心度の高さを身近で感じることができました。



03 SiC基板の超平坦化および加工機構解明の研究を開始

当社の「硬脆材料基板の表面平坦化技術と評価技術に関する研究開発」が、経済産業省の平成17年度新規産業創造技術開発費補助事業(省エネ枠)に選定されました。この研究開発は、SiC基板の格子欠陥(格子歪み等)が無い超平坦な表面を得る加工技術とその評価技術に、当社の保有する超精密研磨技術とノウハウが有効に活用できることから、早期に技術が確立できるものと期待しています。

04 台湾に駐在員事務所開設

台湾および中国における現地CMPユーザーへの技術サービスの提供・商機捕捉を目的として、10月に「フジミ台湾事務所」(新竹縣竹北市)を開設しました。年々台湾向けの売上が増加傾向にあり、それを維持拡大していくためには顧客満足度を高めることが最重要課題となります。タイムリーな顧客サービスにより台湾・中国地域での売上拡大に注力していきます。



株式情報 (平成17年9月30日現在)

株式の状況

株式数	会社が発行する株式の総数	120,000,000株
	発行済株式総数	30,699,500株
	株主数	6,169名

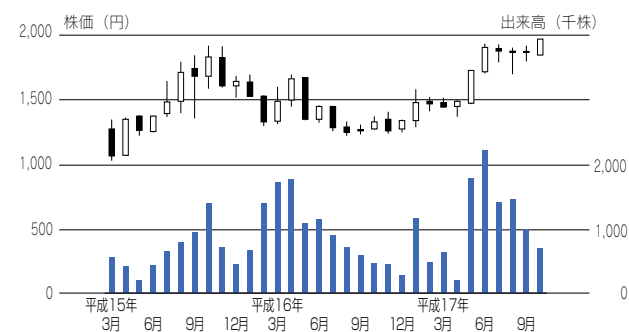
大株主

株主名	持株数	持株比率
越山 勇	3,302,310株	10.8%
野田 純孝	2,840,000	9.3
有限会社コマ	1,638,360	5.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,510,500	4.9
株式会社フジミインコーポレーテッド	1,304,905	4.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,293,000	4.2
越山 彰	1,141,400	3.7
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 505019	821,900	2.7
日本生命保険相互会社	779,880	2.5
株式会社りそな銀行	691,784	2.3

役員 (平成17年9月30日現在)

代表取締役社長	越山 彰
常務取締役	永利 正
取締役	久保 昌昭
取締役	児玉 一志
取締役	中川 博行
取締役	松島 伸男
取締役	関 敬史
常勤監査役	藤本 俊之
常勤監査役	野田 純孝
監査役	鮎澤 多俊
監査役	山下 紀雄

株価および出来高の推移



* 株価データは、株式分割を過年度に遡及して調整した修正株価を使用しています。
* 平成17年3月31日の最終株主名簿および実質株主名簿に記載された株主様に対し、1株に対し2株の割合をもって分割を行いました。

株主分布状況 (平成17年9月30日現在)

